

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC
748-22-1**

QC 760201
Première édition
First edition
1991-11

**Dispositifs à semiconducteurs
Circuits intégrés**

Vingt-deuxième partie:

Section un: Spécification particulière cadre pour les circuits intégrés à couches, et les circuits intégrés hybrides à couches, sur la base des procédures d'agrément de savoir-faire

**Semiconductor devices
Integrated circuits**

Part 22:

Section One: Blank detail specification for film integrated circuits and hybrid film integrated circuits on the basis of the capability approval procedures



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 748-22-1: 1991

AVA Documents
Document Sharing Hub

Numéros des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique.

Des renseignements relatifs à la date de reconfirmation de la publication sont disponibles dans le Catalogue de la CEI.

Les renseignements relatifs à des questions à l'étude et des travaux en cours entrepris par le comité technique qui a établi cette publication, ainsi que la liste des publications établies, se trouvent dans les documents ci-dessous:

- «Site web» de la CEI*
- **Catalogue des publications de la CEI**
Publié annuellement et mis à jour régulièrement (Catalogue en ligne)*
- **Bulletin de la CEI**
Disponible à la fois au «site web» de la CEI* et comme périodique imprimé

Terminologie, symboles graphiques et littéraux

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se reportera à la CEI 60050: *Vocabulaire Electrotechnique International* (VEI).

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux et les signes d'usage général approuvés par la CEI, le lecteur consultera la CEI 60027: *Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique*, la CEI 60417: *Symboles graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et compilation des feuilles individuelles*, et la CEI 60617: *Symboles graphiques pour schémas*.

* Voir adresse «site web» sur la page de titre.

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications including amendments are available. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the publication is available in the IEC catalogue.

Information on the subjects under consideration and work in progress undertaken by the technical committee which has prepared this publication, as well as the list of publications issued, is to be found at the following IEC sources:

- **IEC web site***
- **Catalogue of IEC publications**
Published yearly with regular updates (On-line catalogue)*
- **IEC Bulletin**
Available both at the IEC web site* and as a printed periodical

Terminology, graphical and letter symbols

For general terminology, readers are referred to IEC 60050: *International Electrotechnical Vocabulary* (IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved by the IEC for general use, readers are referred to publications IEC 60027: *Letter symbols to be used in electrical technology*, IEC 60417: *Graphical symbols for use on equipment. Index, survey and compilation of the single sheets* and IEC 60617: *Graphical symbols for diagrams*.

* See web site address on title page.

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC
748-22-1**

**QC 760201
Première édition
First edition
1991-11**

**Dispositifs à semiconducteurs
Circuits intégrés**

Vingt-deuxième partie:

**Section un: Spécification particulière cadre pour les
circuits intégrés à couches, et les circuits intégrés
hybrides à couches, sur la base des procédures
d'agrément de savoir-faire**

**Semiconductor devices
Integrated circuits**

Part 22:

**Section One: Blank detail specification for film
integrated circuits and hybrid film integrated circuits
on the basis of the capability approval procedures**

© CEI 1991 Droits de reproduction réservés — Copyright — all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni
utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé,
électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les
microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized
in any form or by any means, electronic or mechanical,
including photocopying and microfilm, without permission
in writing from the publisher

Bureau central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembe Genève Suisse



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

L

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue



Documents

Document Sharing Hub

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS CIRCUITS INTÉGRÉS

Vingt-deuxième partie – Section un: Spécification particulière cadre pour les circuits intégrés à couches, et les circuits intégrés hybrides à couches, sur la base des procédures d'agrément de savoir-faire

AVANT-PROPOS

- 1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.
- 2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.
- 3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le vœu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où les conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

La présente norme a été établie par le Sous-Comité 47A: Circuits intégrés, du Comité d'Etudes n° 47 de la CEI: Dispositifs à semiconducteurs.

Cette norme est une spécification particulière cadre pour les circuits intégrés à couches, et les circuits intégrés hybrides à couches, sur la base des procédures d'agrément de savoir-faire.

Le texte de cette publication est issu des documents suivants:

Règle des Six Mois	Rapport de vote
47A(BC)184	47A(BC)228

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette publication.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le numéro de spécification dans le Système CEI d'assurance de la qualité des composants électroniques (IEQC).

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES
INTEGRATED CIRCUITSPart 22 – Section One: Blank detail specification for film
integrated circuits and hybrid film integrated
circuits on the basis of the capability approval
procedures

FOREWORD

- 1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.
- 2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt the text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the IEC recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.

This standard has been prepared by IEC Sub-Committee 47A: Integrated circuits, of IEC Technical Committee No. 47: Semiconductor devices.

This standard is a blank detail specification for film integrated circuits and hybrid film integrated circuits on the basis of the capability approval procedure.

The text of this standard is based on the following documents:

Six Months' Rule	Report on Voting
47A(CO)184	47A(CO)228

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the Voting Report indicated in the above table.

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification number in the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).

Les publications suivantes de la CEI sont citées dans la présente norme:

Publications n ^{os}	191-2 (1966):	Normalisation mécanique des dispositifs à semiconducteurs. Deuxième partie: Dimensions.
	410 (1973):	Plans et règles d'échantillonnage pour les contrôles par attributs.
	748-20 (1988):	Dispositifs à semiconducteurs. Circuits intégrés. Vingtième partie: Spécification générique pour les circuits intégrés à couches et les circuits intégrés hybrides à couches.
	748-22 (1991)	Vingt-deuxième partie: Spécification intermédiaire pour les circuits intégrés à couches et les circuits intégrés hybrides à couches sur la base des procédures d'agrément de savoir-faire.

Withdrawn

The following IEC publications are quoted in this standard:

- Publications Nos. 191-2 (1966): Mechanical standardization of semiconductor devices. Part 2: Dimensions.
- 410 (1973): Sampling plans and procedures for inspection by attributes.
- 748-20 (1988): Semiconductor devices. Integrated circuits. Part 20: Generic specification for film integrated circuits and hybrid film integrated circuits.
- 748-22 (1991): Part 22: Sectional specification for film integrated circuits and hybrid film integrated circuits on the basis of the capability approval procedures.

Withdrawn

DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS CIRCUITS INTÉGRÉS

Vingt-deuxième partie – Section un: Spécification particulière cadre pour les circuits intégrés à couches, et les circuits intégrés hybrides à couches, sur la base des procédures d'agrément de savoir-faire

INTRODUCTION

Le Système CEI d'assurance de la qualité des composants électroniques fonctionne conformément aux statuts de la CEI et sous son autorité. Le but de ce système est de définir les procédures d'assurance de la qualité de telle façon que les composants électroniques livrés par un pays participant comme étant conformes aux exigences d'une spécification applicable soient également acceptables dans les autres pays participants sans nécessiter d'autres essais.

Cette spécification particulière cadre fait partie d'une série de spécifications particulières cadres concernant les dispositifs à semiconducteurs; elle doit être utilisée avec la publication suivante de la CEI:

748-20/QC 760000: Dispositifs à semiconducteurs. Circuits intégrés. Vingtème partie: Spécification générique pour les circuits intégrés à couches et les circuits intégrés hybrides à couches.

- a) Pour les circuits catalogue, les spécifications particulières sont publiées; leur présentation et leur contenu minimal doivent être conformes au tableau 2.
- b) Pour les circuits à la demande, les spécifications particulières ne sont pas publiées; leur présentation et leur contenu sont optionnels.

Toutefois, les exigences du client concernant l'encombrement et la fonction doivent être vérifiées soit par les essais prescrits pour le maintien de l'agrément de savoir-faire soit comme spécifié en spécification particulière soit par la combinaison des deux.

- c) Pour les CQC, les spécifications particulières ne sont pas publiées; leur présentation et leur contenu doivent être conformes au tableau 2.

Lorsqu'un circuit non fini est vendu pour finition par un tiers, le produit fini résultant ne peut être livré comme produit qualifié selon le Système IECQ, sauf si toutes les opérations sont effectuées par un ou plusieurs fabricants agréés.

Dans la préparation des spécifications particulières, le contenu du paragraphe 3.6.2 de la spécification générique et des paragraphes 2.3 et 3.3 de la spécification intermédiaire doit être pris en compte.

SEMICONDUCTOR DEVICES INTEGRATED CIRCUITS

Part 22 – Section One: Blank detail specification for film integrated circuits and hybrid film integrated circuits on the basis of the capability approval procedures

INTRODUCTION

The IEC Quality Assessment System for Electronic Components is operated in accordance with the statutes of the IEC and under the authority of the IEC. The object of this system is to define quality assessment procedures in such a manner that electronic components released by one participating country as conforming with the requirements of an applicable specification are equally acceptable in all other participating countries without the need for further testing.

This blank detail specification is one of a series of blank detail specifications for semiconductor devices and shall be used with the following IEC publication:

748-20/QC 760000: Semiconductor devices. Integrated circuits. Part 20: Generic specification for film integrated circuits and hybrid film integrated circuits.

- a) For catalogue circuits, the detail specifications are published and their format and minimum content shall conform with Table 2.
- b) For custom circuits, the detail specifications are not published and their format and content are optional.

However, the customer's requirements in relation to form, fit and function shall be verified either by the routine tests in maintenance of capability approval or as specified in the detail specification or by both in combination.

- c) For CQC's, the detail specifications are not published; their format and content shall conform with Table 2.

When a circuit is sold uncompleted for completion by another party, the completed product does not qualify for release under the IEC system unless all processes are carried out by one or more approved manufacturers.

In the preparation of detail specifications, the content of subclause 3.6.2 of the generic specification and subclauses 2.3 and 3.3 of the sectional specification shall be taken into account.